

2022년 4월 26일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

\* 통신·방송·인터넷은 4월 25일(월) 12:00 이후 보도 가능



중소벤처기업부

# 보도자료



• 문의 : 기술보호과 노진상 과장(044-204-7780), 김영환 사무관(7782), 조성혜 주무관(7787)

## '22년 테크브리지(Tech-Bridge)활용 상용화 연구개발(R&D) 하반기 과제 참여기업 모집

- 기술거래 체제(플랫폼)(Tech-Bridge)를 통해 기술을 이전받은 중소기업의 소재·부품·장비 분야 기술경쟁력 강화 및 기술자립 맞춤형 지원
  - '기술이전-후속 상용화연구개발(R&D)-양산자금' 일괄묶음(원스톱(One-Stop) 패키지) 지원
- 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 에서 신청('22 하반기 20개, 5.11(수)~5.25(수))

중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 4월 26일(화)부터 '2022년 하반기 테크브리지(Tech-Bridge)활용 상용화기술개발 사업' 20개 과제 참여기업 모집을 공고하고, 5월 11일(수)부터 접수를 받는다.

해당 사업은 국내 소재·부품·장비 분야 중소기업의 기술경쟁력 및 기술사업화 역량을 제고하기 위해 시행하는 지원 사업으로,

### < '22년 테크브리지(Tech-Bridge)활용 상용화 기술개발(R&D)사업 지원 개요 >

- (개요) 독자적인 기술개발이 어려운 중소기업이 국내 우수 산·학·연이 보유한 핵심기술을 테크브리지(Tech-Bridge)플랫폼을 통해 이전받아 사업화를 할 수 있도록 지원하는 대표적인 상용화 연구개발(R&D) 사업

내역사업명	'22 예산	신규과제		지원규모	총사업비
		분기	과제수(개)		
수요기반 기술이전	350억	상	20	최대 2년, 8억원	2,525억 ( '20년 ~ '27년)
		하	20		

중기부는 ①중소기업의 기술·사업화 수요에 부합하는 소재·부품·장비 분야 우수기술을 확보하기 위해 공모과제 발굴을 민간기관으로 확대해 공모과제(RFP, Request For Proposal)를 엄선한다.

또한, ②기술활용 목적에 부합하는 체계화된 기술연결(매칭)을 지원하고,

③기술보증기금에서 운용 중인 '지식재산(IP)인수 보증\*' 및 '사업화 보증\*\*'과 연계해 일괄묶음(원스톱(One-Stop)패키지)을 지원한다.

\* (IP 인수 보증) 지식재산(IP) 인수 추진 기업에게 지식재산(IP)인수를 위한 자금(착수금, 기술료 등) 보증

\*\* (사업화 보증) 연구개발(R&D) 완료 후 제품양산에 소요되는 운전, 시설자금 보증

이를 통해, 기술이전 비용 부담을 완화하고 사업화 성공률을 높이는 등 중소기업의 기술경쟁력이 한층 더 강화될 수 있도록 적극적으로 뒷받침할 예정이다.

아울러, 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 중소·벤처기업의 자금 부담을 덜어주고자, 현재 시행중인 '기술개발(R&D) 참여기업 민간부담 및 현금부담 비율 완화 조치'는 하반기 지원사업에도 동일하게 적용된다.

\* 민간부담 비율 : 최대 25% → 20%, 현금부담 비율 : 최대 60% → 10% 하향조정

신청은 5월 11일(수)부터 5월 25일(수)까지 가능하며, 자세한 내용은 범부처 통합연구지원시스템(www.iris.go.kr)을 통해 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 중소벤처기업부 기술보호과 김영환 사무관(☎ 044-204-7782)에게 연락주시기 바랍니다.

□ **사업목적** : 소재·부품·장비 분야 중소기업의 공공기술이전 활성화 촉진 및 R&D 지원을 통한 기술·사업화 역량 제고

□ **지원규모** : 350억원('22년, 신규과제 40개, 계속과제 90개)

□ **지원대상**

○ **(주관기관)** 소재·부품·장비분야 공공기술을 이전\*받아 후속 상용화 기술개발을 하고자하는 중소기업

\* 과제신청접수 마감일 기준, 1년 이내 기술이전 계약을 체결한 기술(4개월 이내 계약체결 예정 포함)

○ **(공동개발기관)** 주관기관에 기술을 이전하는 대학·연구기관 등

\* 기술이전기관(공공기술 보유한 대학, 출연연 등) 필수 참여

□ **지원내용** : Tech-Bridge 플랫폼을 통해 소재·부품·장비 분야의 기술 이전을 받은 중소기업에 이전기술의 후속 상용화 기술개발자금 지원

- “기술이전-후속 상용화 R&D-양산자금”로 이어지는 One-stop패키지 지원

□ **지원조건**

구 분	개발기간 및 지원한도*	정부출연금 비중	지원방식
수요기반 기술이전	최대 2년, 8억원 (연 4억원)	75% 이내	지정공모

\* 코로나19 특별지침에 따라 정부출연금 비중 변경 가능

## 참고 2

# 기술보증기금 Tech-Bridge 플랫폼 개요

### □ 개요 및 특징

- 중소기업 개방형 혁신 등을 목적으로 연구소 등이 보유중인 공급 기술과 중소기업의 수요기술을 연결하는 기술이전 플랫폼
- 대학 및 연구소가 보유한 공급기술 외, 기보 전국 영업망을 통해 중소기업의 기술수요DB를 보유한 국내 유일의 플랫폼

### □ 주요기능

- 공급기술 약 40만건 확보, 매년 1,500건 이상의 중소기업 수요기술을 발굴하여 기업, 연구기관, 기술거래기관 등 시장 참여자에게 제공
- 통계분석 모듈을 기반으로 기업의 기술수요와 공공연 기술을 자동 매칭 및 기술을 추천하는 KTMS(Kibo Technology Matching System) 탑재
- \* 기술정보는 기보 내부DB, 공공연 특허DB를 통해 일배치로 업데이트

#### 【 Tech-Bridge의 정보연계 및 기능개요 】



- 참여기관과 온라인에서 정보교환과 협의가 가능한 대화형 화면 제공